

4-1-1-4 藻巻込み銅めっき／镀铜层卷入藻类 / Weed-like deposit of copper

【特徴】 枝状または粒状銅めっき欠陥

【特征】 镀铜层有枝状或者粒状的缺陷。

【Characteristics】 Tree-like or granular-like deposited copper

【原因・判断ポイント・発生工程】 銅めっき前整面工程や、めっき工程中の水や薬液中に発生した藻(微生物)が製品表面に付着し、その上に銅めっきされて出来たもの(銅めっき前整面～銅めっき工程)

【原因、判断要点、发生工序】 在产品表面附着前处理或者电镀工序的水、药液中滋生的藻类(微生物), 然后又进行镀铜所引起的(表面处理～镀铜工序)。

【Causes/processes involved/keys to judgment】
An algae-like substance generated in water or a chemical solution during surface preparation or plating is attached to the surface of a product and plating is made on the algae. (Surface preparation - copper plating)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

4-1-1-5 ダイレクト銅めっき異常／直接镀铜层的异常 / Anomaly in direct copper plating

【特徴】 パネルプレーティング銅の表面がアバタ状になっている欠陥

【特征】 全板镀铜层表面有麻子状的缺陷

【Characteristics】 A panel plated copper has a pitted surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】 めっき対象面に何らかの異物が残っており、そのままダイレクトプレーティングされたため出来たもの(パネルダイレクトプレーティング工程)

【原因、判断要点、发生工序】 镀铜面残留某种杂物, 未经处理就直接电镀所引起的(全板直接电镀工序)。

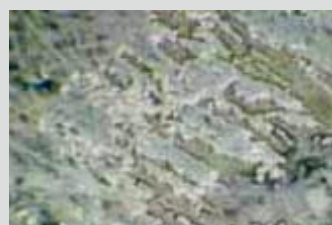
【Causes/processes involved/keys to judgment】
Plating is made on a foreign object left on an area to be plated (Direct plating process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×